

【証券コード：6728】

決算説明会資料

2017年度（2017年7月～2018年6月）

2018年8月9日

株式会社 アルバック

◆将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるFPD（フラット・パネル・ディスプレイ）・半導体・電子部品などの業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

◆本資料における表示方法について

（特段の記載がない限り、数値はすべて連結ベースです）

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

会計期間の表現：

2Q（累計）： 第2四半期連結累計期間

2Q： 第2四半期連結会計期間

□ 2017年度

創業来最高売上高 **3期連続最高益更新**
⇒ **中計最終年度利益計画を達成**

□ 2018年度予想

売上高**2,550億円**、営業利益**365億円**

□ 2019年度（中計最終年度）計画見直し

売上高**2,650億円（+150億円）**
営業利益**380億円（+30億円）**

2017年度連結業績概要

□ 創業来最高の売上高・3期連続最高益更新

□ 受注高 2,430億円（前年同期比 + 3%）

- メモリ向け設備投資の増加等を受け、半導体・電子部品が大幅に増加、コンポーネント等も前年同期を上回る

□ 売上高 2,493億円（前年同期比 + 8%）

- 半導体・電子部品を中心に、前年同期を上回る

□ 営業利益 354億円（前年同期比 + 20%）

- 各利益項目とも、高水準で推移し、前年同期を上回る

□ 配当

- 配当金（1株当たり）95円（前年度比 + 45円）

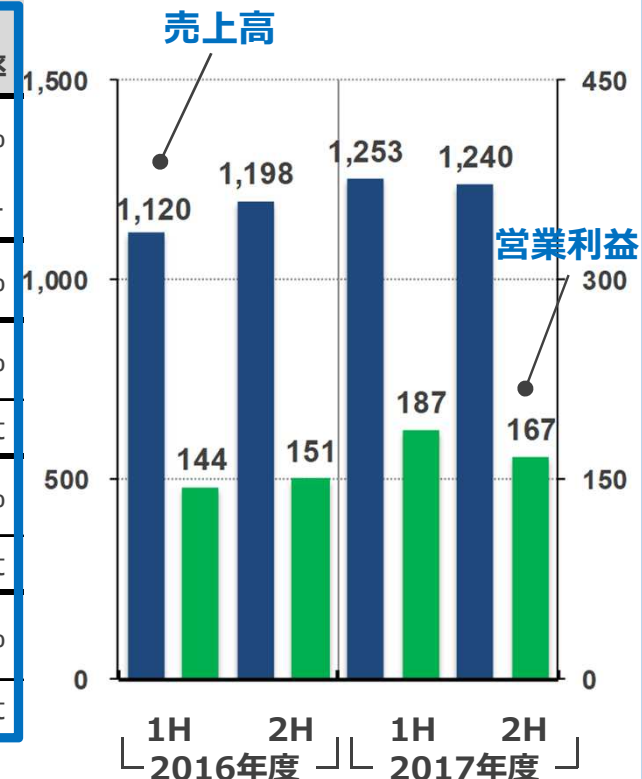
2017年度連結業績概要

- ・ 受注高・売上高・各利益項目において前年同期を上回る
- ・ 営業利益率も、前年同期比1.5ポイント上昇、半導体・電子部品製造装置等が寄与
- ・ 当期純利益は、繰延税金資産や株式売却益の計上等もあり47%増

【単位：億円】 売上高と営業利益の推移（半期毎）

| | 2016年度 通期 実績 | 2017年度 | | 前年同期比 | |
|---------------------|--------------------|------------|--------------|-------|-----------|
| | | 当初予想 *1 | 前回修正 予想*2 | 実績 | 増減率 |
| 受注高 | 2,355 | 2,450 | 2,650 | 2,430 | 75 3.2% |
| 期末受注残高 | 1,063 | - | - | 1,000 | - - |
| 売上高 | 2,318 | 2,390 | 2,500 | 2,493 | 174 7.5% |
| 営業利益 | 295 | 310 | 355 | 354 | 59 20.0% |
| 率 | 12.7% | 13.0% | 14.2% | 14.2% | + 1.5 pt |
| 経常利益 | 297 | 310 | 360 | 369 | 72 24.2% |
| 率 | 12.8% | 13.0% | 14.4% | 14.8% | + 2.0 pt |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 245 | 255 | 305 | 359 | 114 46.7% |
| 率 | 10.6% | 10.7% | 12.2% | 14.4% | + 3.8 pt |

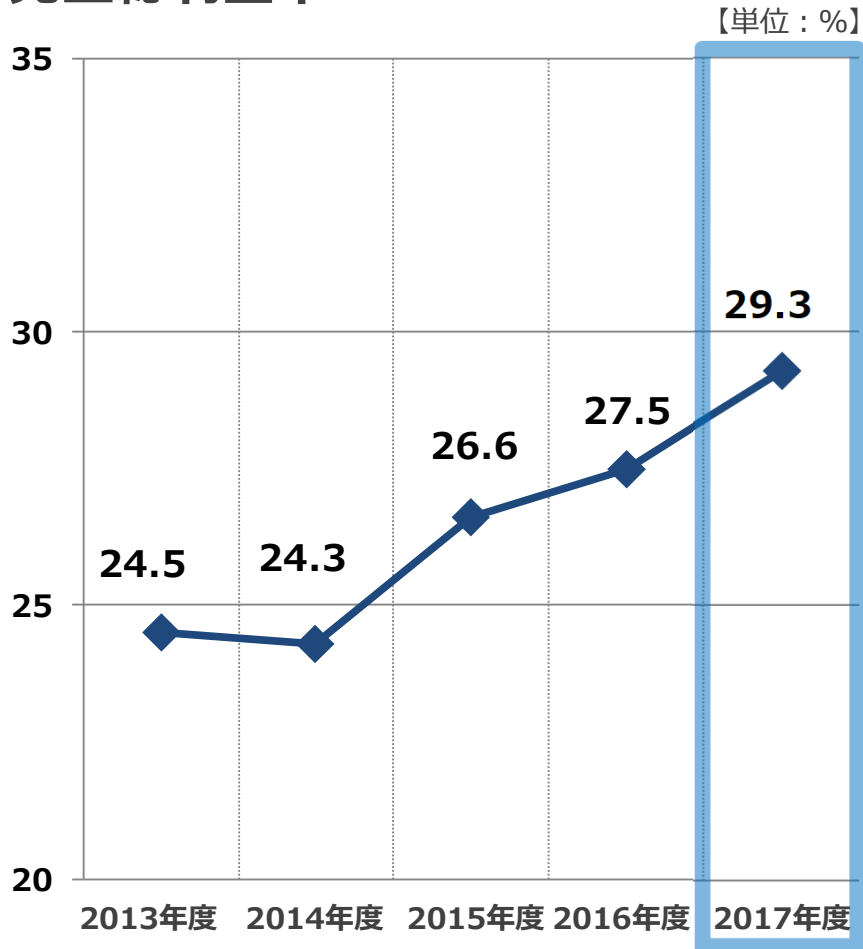
*1：2017年 8月公表値 *2：2018年 2月公表値



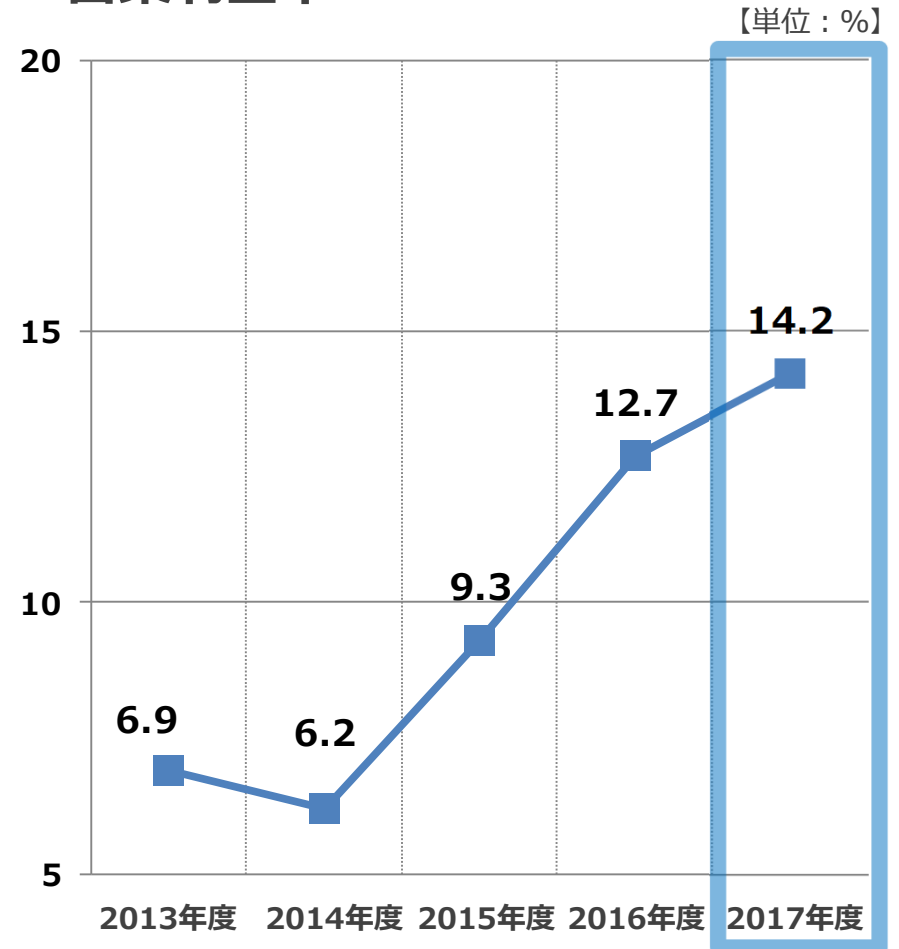
2017年度連結業績概要 (利益率)

- 利益率の高い半導体及び電子部品製造装置のウエイト増等により、売上総利益率・営業利益率とも上昇

売上総利益率



営業利益率

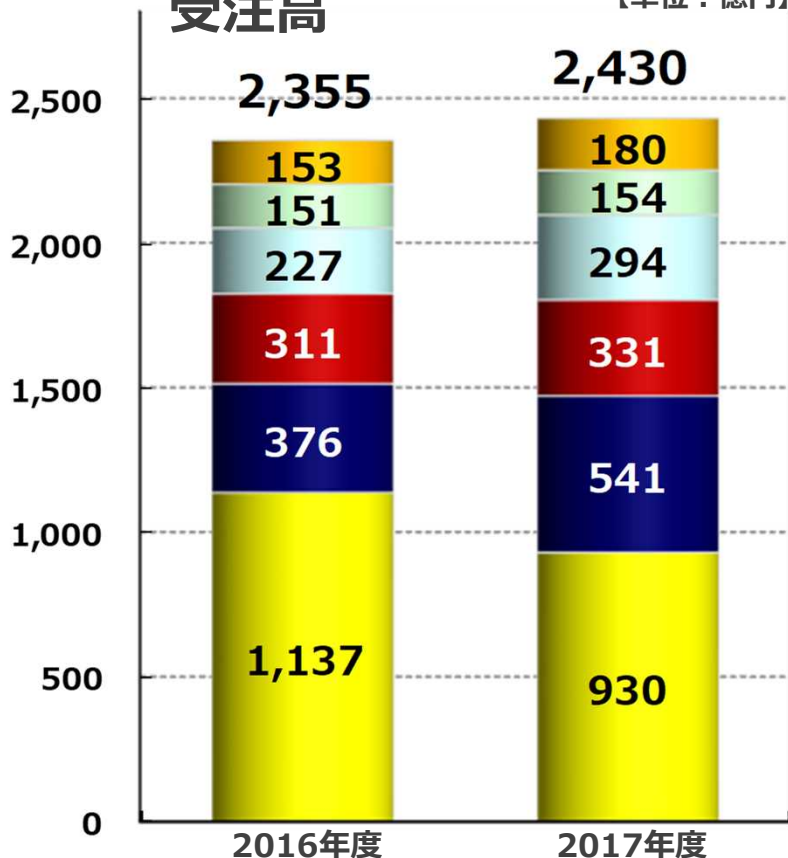


2017年度連結業績概要 (品目別受注高・売上高)

- FPD・PV製造装置：中国を中心に、大型TV向けLCD（液晶）やスマートフォン向けOLED（有機EL）投資が高水準で継続
- 半導体・電子部品製造装置：旺盛なサーバー需要を背景に、メモリ（NAND・DRAM・次世代不揮発性メモリ）向け製造装置が増加。前年同期を大きく上回る

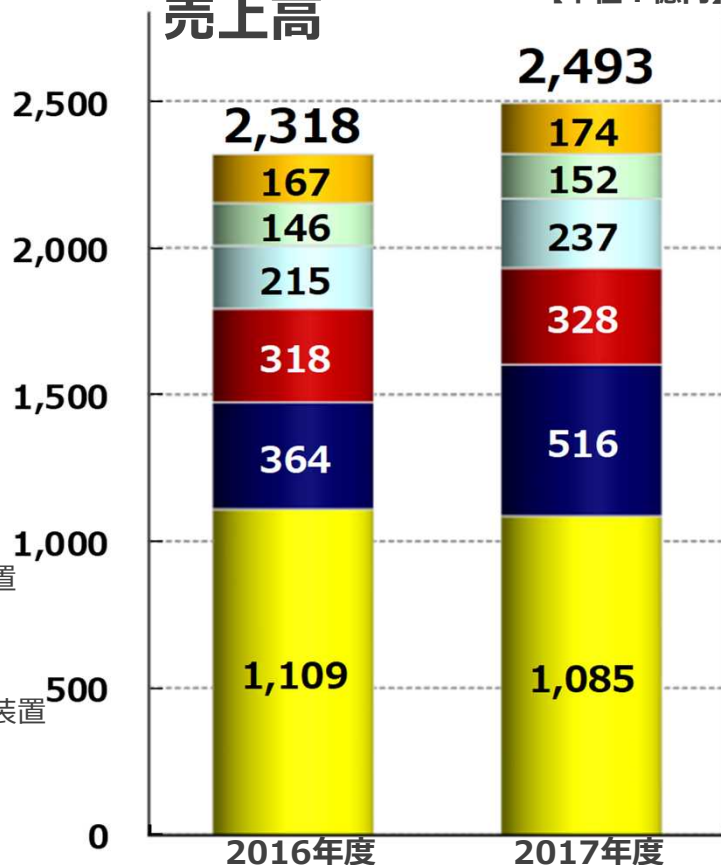
受注高

【単位：億円】



売上高

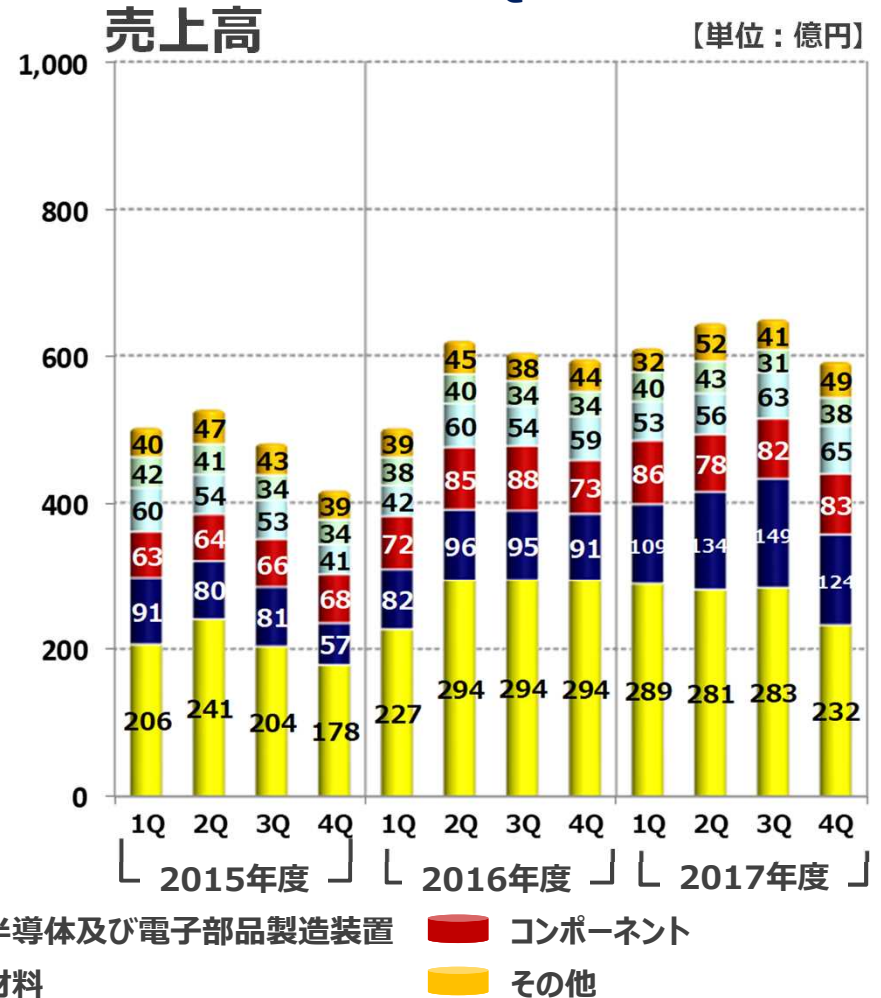
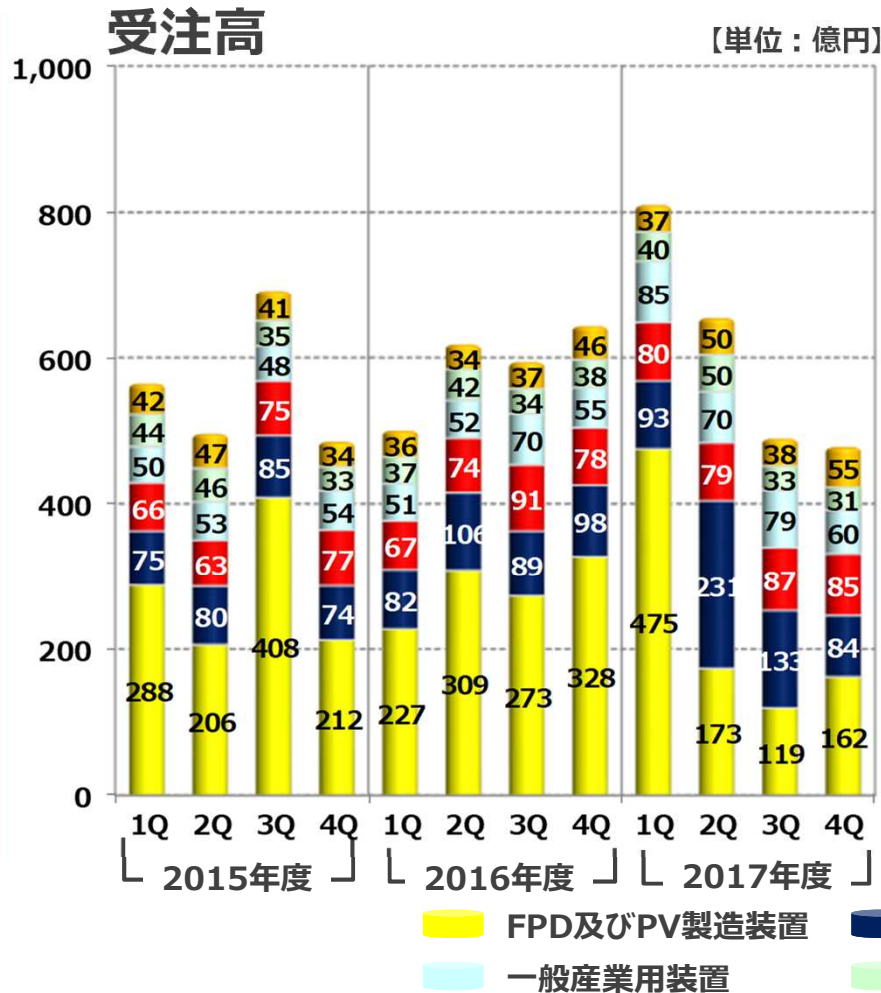
【単位：億円】



- その他
- 材料
- 一般産業用装置
- コンポーネント
- 半導体及び電子部品製造装置
- FPD及びPV製造装置

2017年度連結業績概要 (品目別受注高・売上高：四半期)

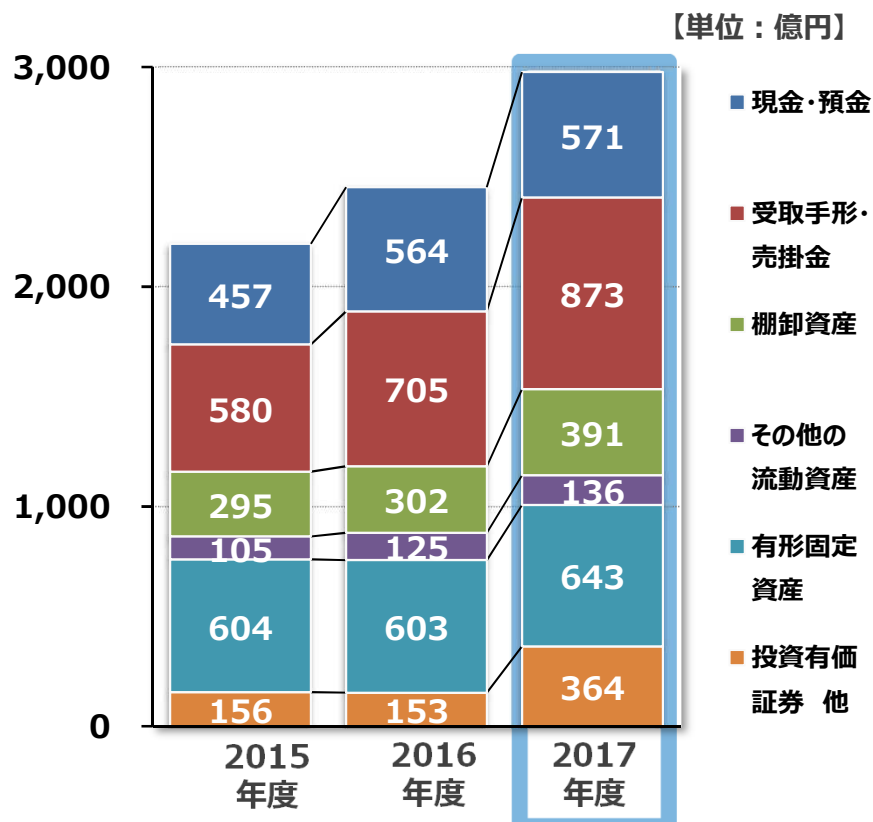
- 売上高は引き続き高水準で推移
- 受注高は当初計画時より1Qの商談集中を想定（上期1,400億円・下期1,050億円）
- 6月に予定していた大型案件の翌期スライドにより一時的に低調（翌1Q回復見込み）



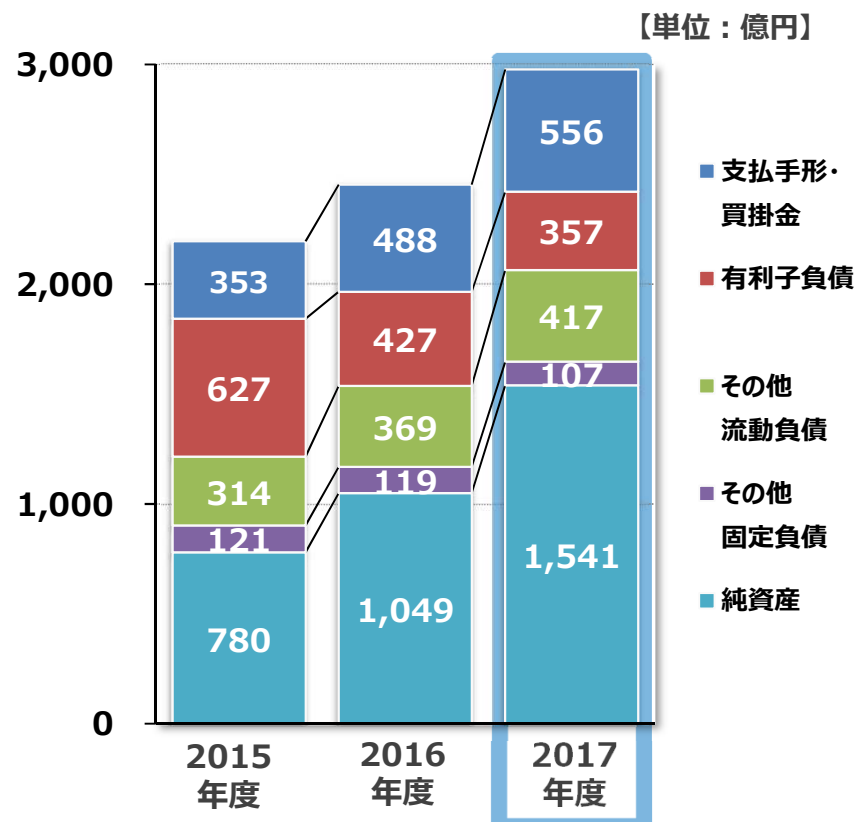
2017年度連結業績概要 (連結貸借対照表)

- 受注及び売上増加に伴い総資産が増加しているが、当期利益に加え投資有価証券の時価評価額の増加により純資産も492億円増加し、自己資本比率は49.5%にまで改善
- 有利子負債は70億円減少し、ネットキャッシュは214億円まで改善

資産



負債・純資産

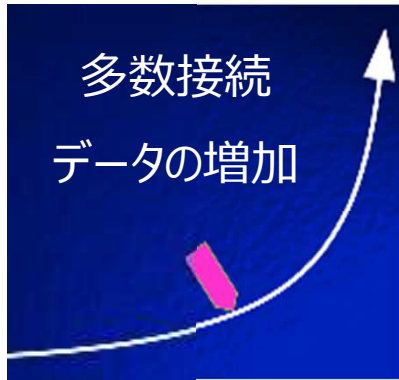


中期経営計画の見直し

中期経営計画の見直し (ビジネス環境)

5Gで加速するスマート社会化
超高速 x100
超低遅延 x1/10
多数同時接続 x100

スマート社会実現に
必要な技術革新



サーバーの
大容量化
高速処理
低消費電力化

各種デバイスの
多機能化
環境耐性
小型・低コスト化
自立駆動
新エネルギー

技術革新の波



大容量
高速処理
低消費電力

次世代
不揮発性メモリ
NVM

ロジック

3D-NAND

DRAM

数十年に一度のビッグチャンス



多機能・環境耐性
小型・低コスト
自立駆動・新エネルギー

高周波デバイス
マルチバンド
SAW・BAW

多機能センサー
MEMS

パワーデバイス
SiC
GaN

基地局
GaN
RFデバイス

高精細表示
フレキシブル
OLED

高効率
太陽電池

通信インフラ
光ファイバー
導波路

イメージング
デバイス

蓄電
TFB
キャパシター

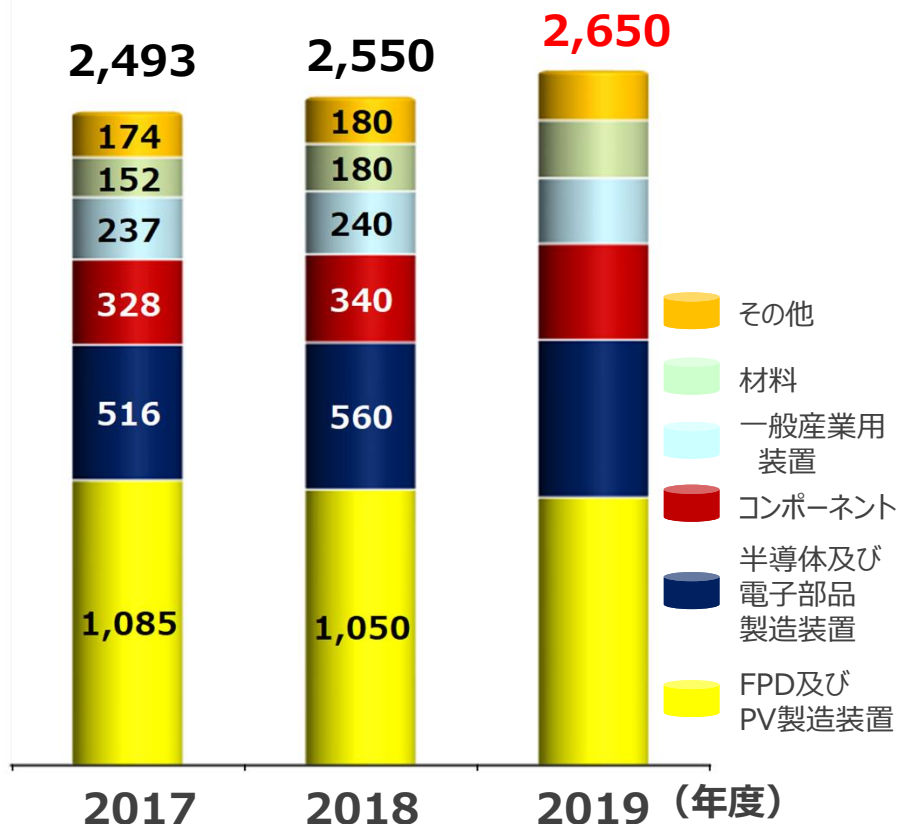
中期経営計画の見直し (2019年度計画)

2019年度計画見直し

売上高 2,650億円 (+150億円)、営業利益 380億円 (+30億円)

・現中期経営計画骨子に変更なく、計画値のみ見直し

2019年度売上高計画(単位：億円)



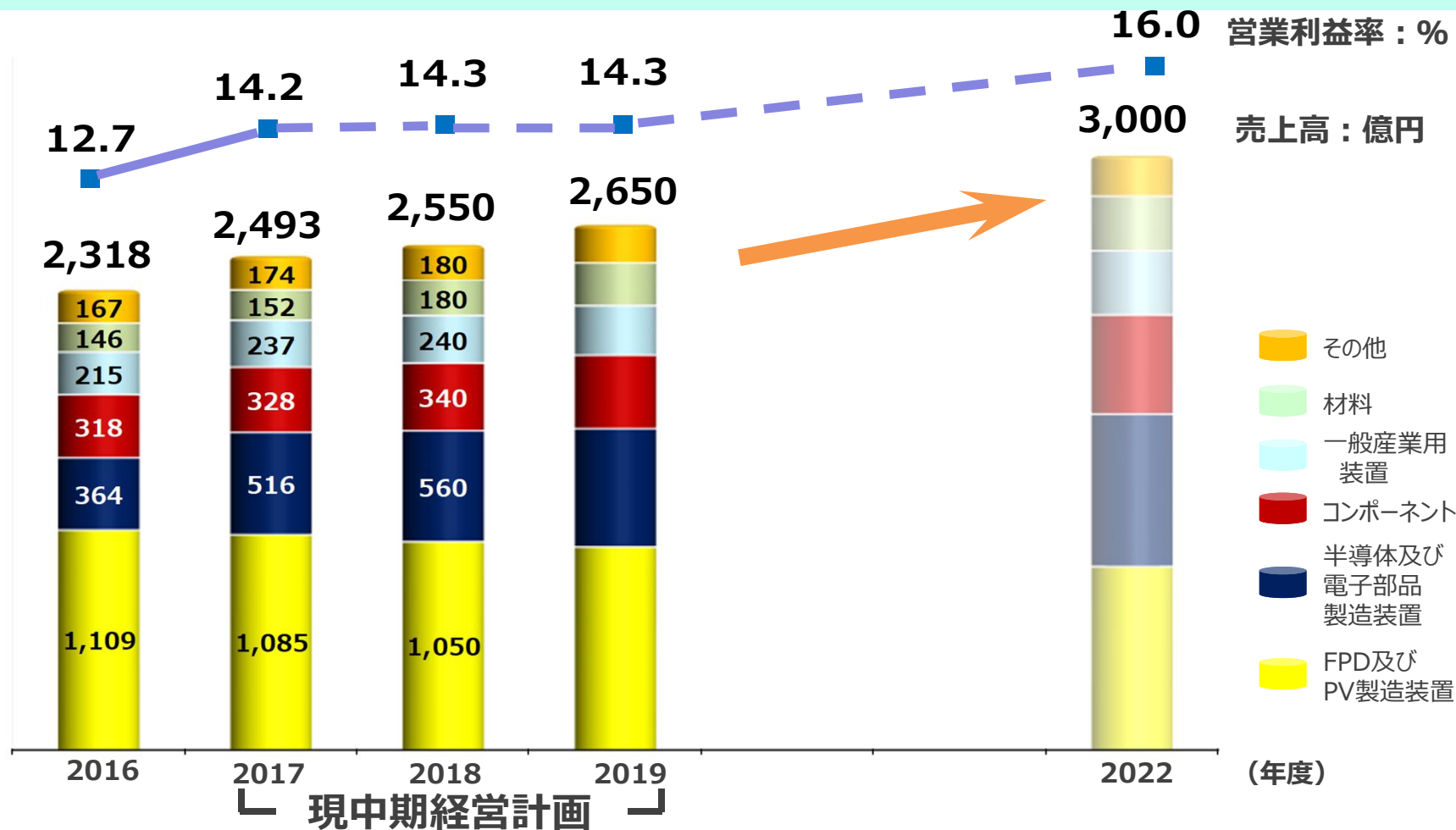
【成長戦略】

- ・ 半導体はメモリとロジックの両輪で成長
- ・ 電子は5Gで加速する技術革新をビジネスチャンスに成長
- ・ FPDは大型TV・OLED投資を中心に長期的継続投資に対応
- ・ コンポーネント・マテリアル・カスタマーサポートの成長 (安定基盤)
- ・ 中国市場における成長

中期経営計画の見直し (目指す姿)

2022年度は、売上高3,000億円、営業利益率16%を目指す

・半導体（メモリに加えロジックが成長）、電子部品（スマート化で成長）、
コンポーネント等利益率の高い複数の事業が柱として成長



FPD関連の長期的な継続投資が見込まれる

- ・大型TV向け投資の継続
- ・OLED製造装置は

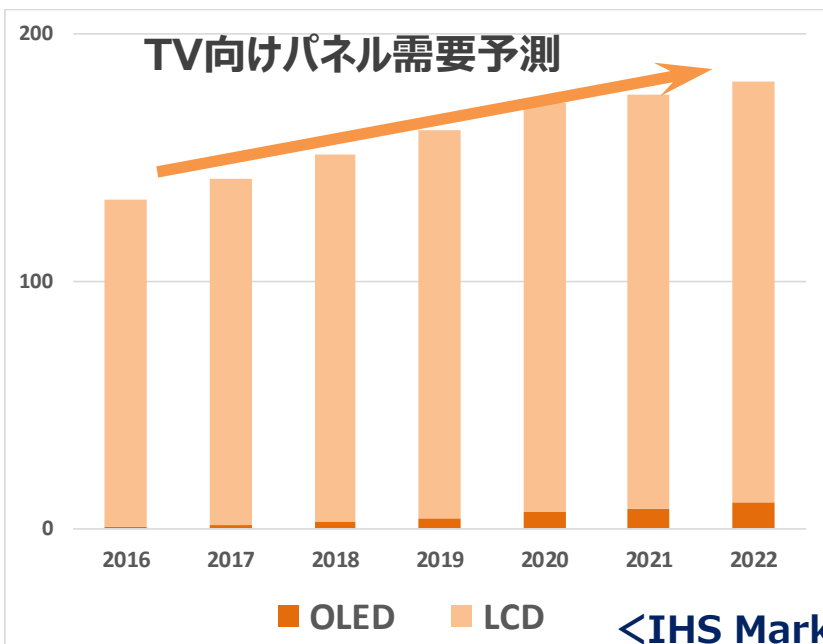
スマートフォン向：韓国は足元投資抑制

中国での設備投資継続

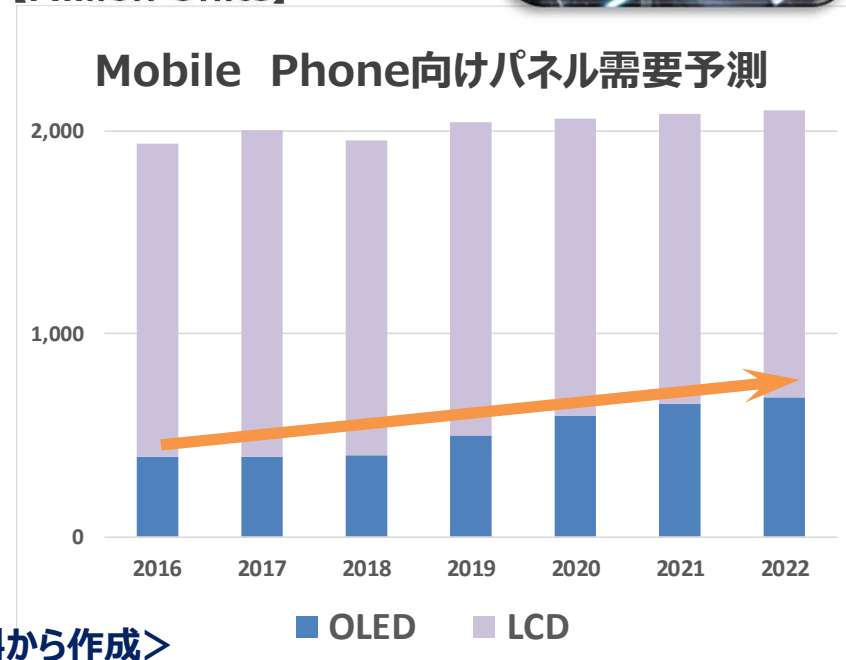
今後のOLED市場はフレキシブル性活用・TV等で拡大



【Million m²】

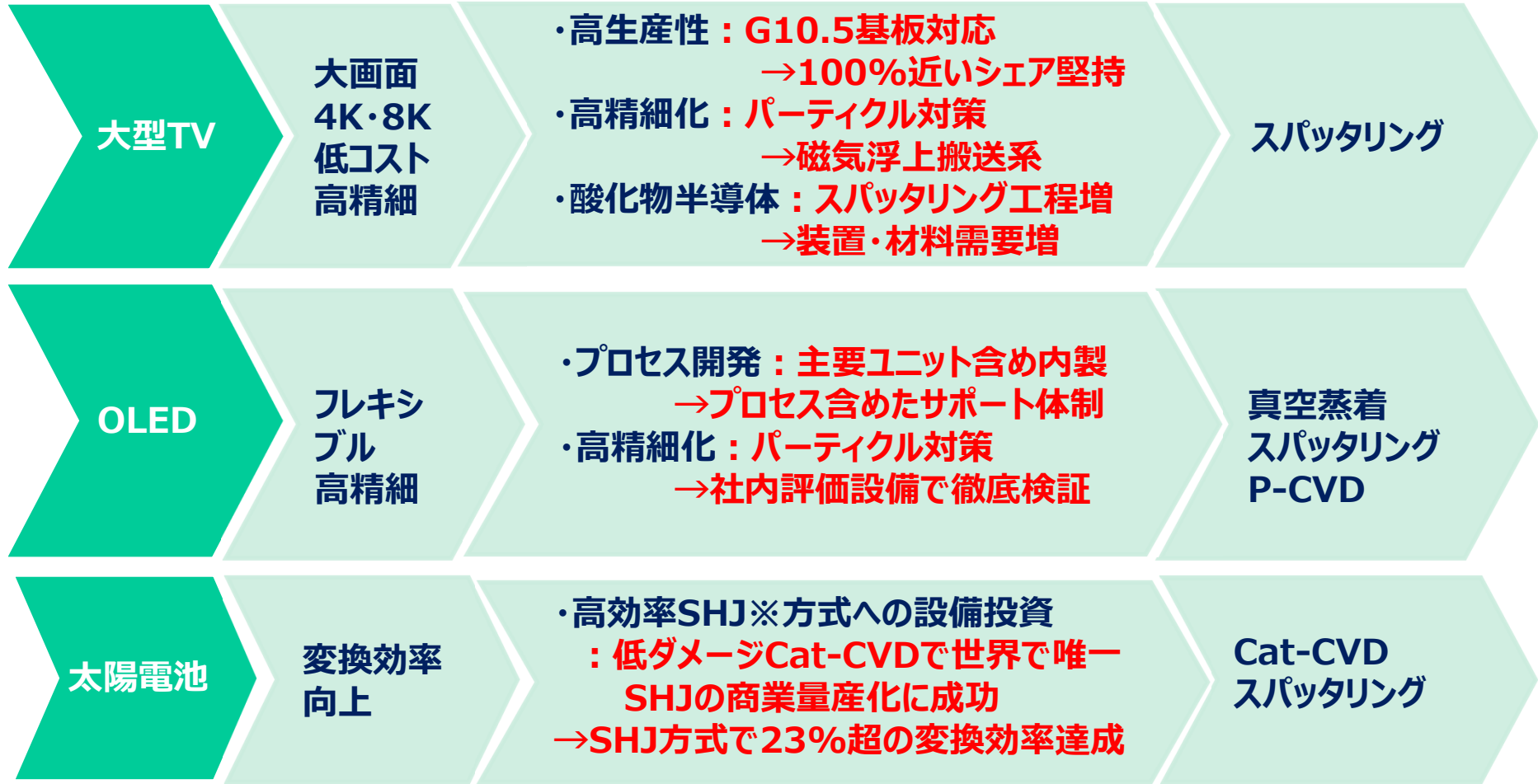


【Million Units】



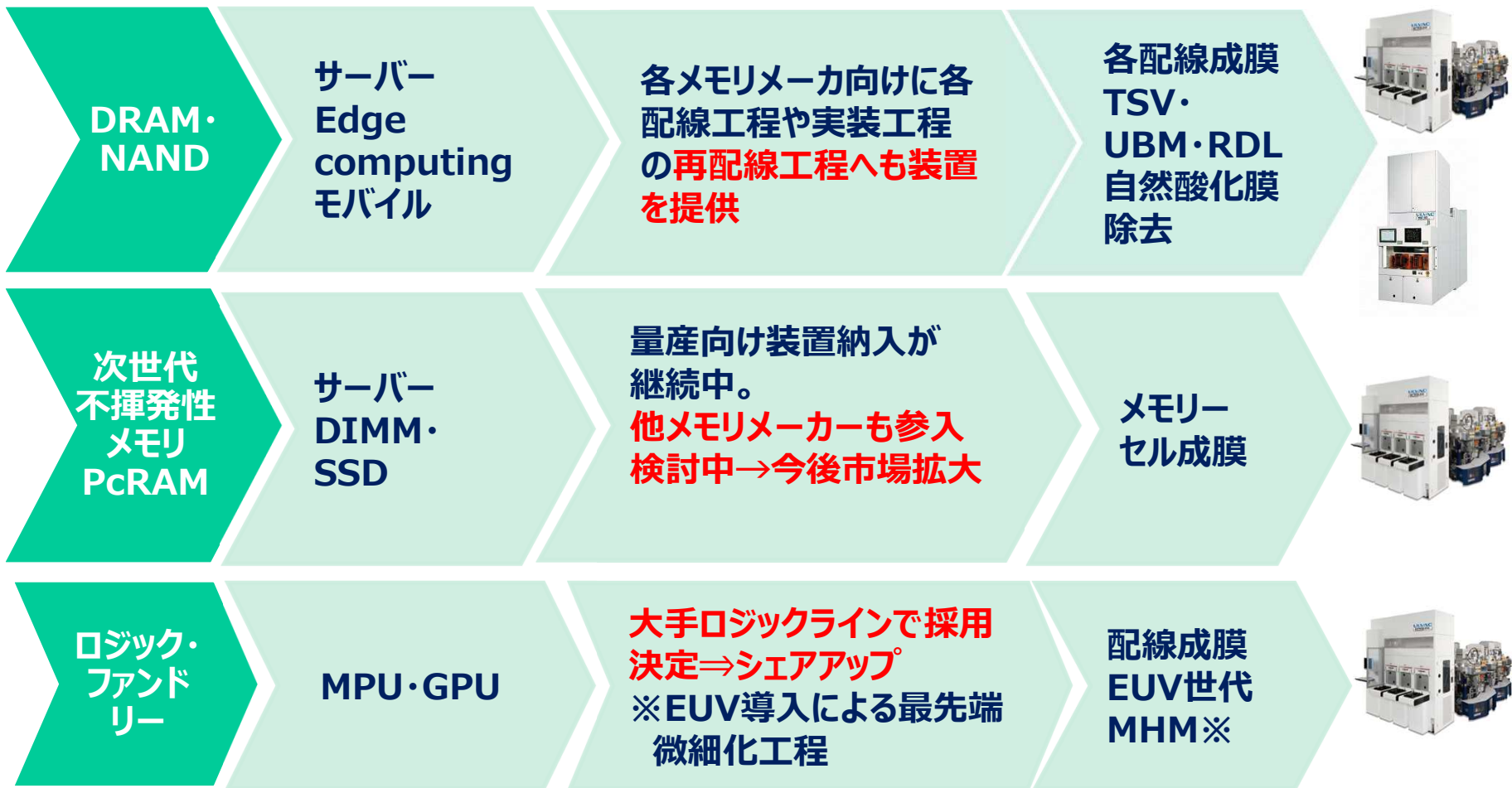
<IHS Markit資料から作成>

大型TVやOLED等投資は継続、高効率太陽電池向けも中国で投資活発化



※SHJ : シリコン ヘテロ ジャンクション

メモリ (NAND・DRAM・PcRAM) とロジックの両輪で成長

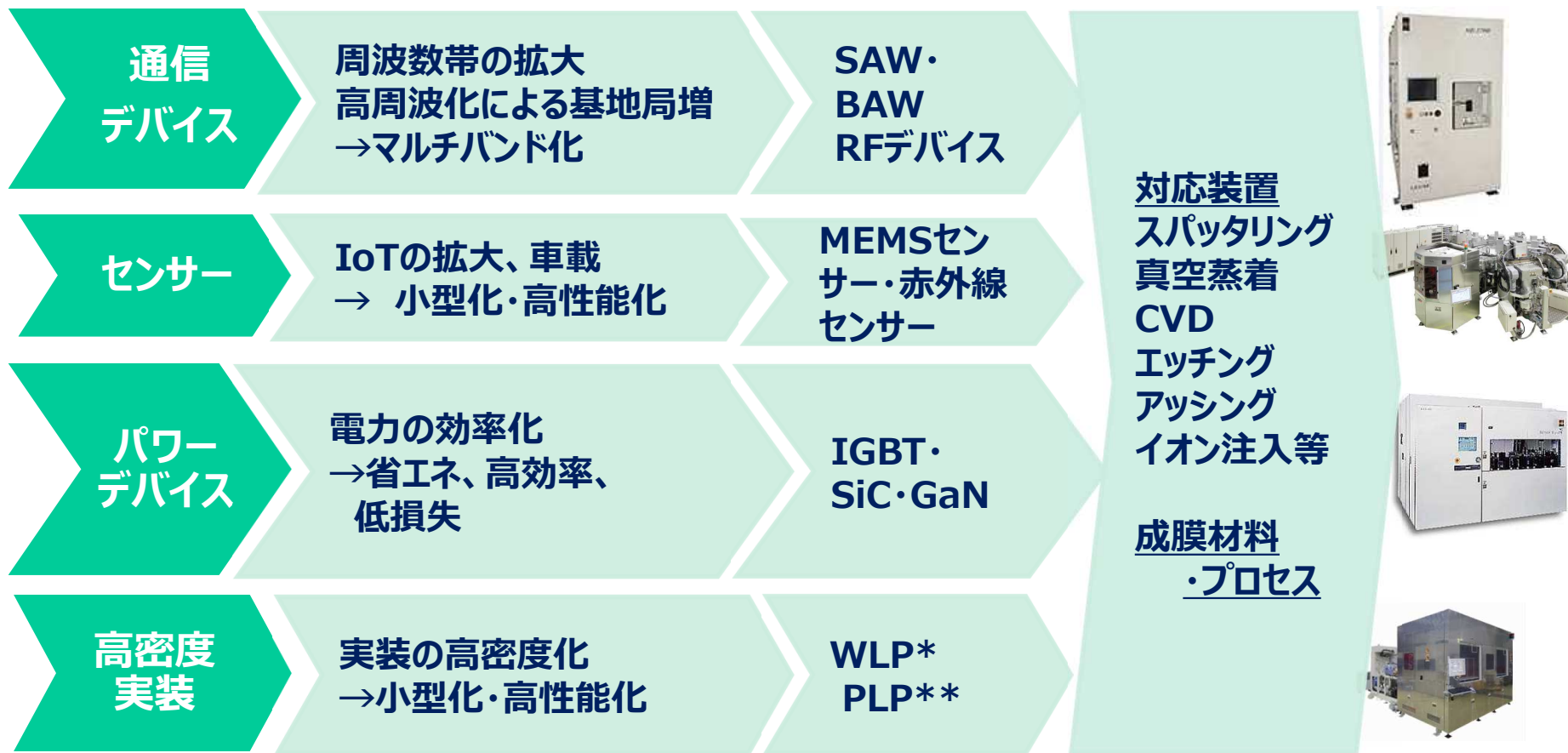


※ Metal Hard Mask

5Gで加速する技術革新⇒電子部品製造装置のビジネスチャンス拡大

電子デバイスの小型化／微細化／高密度化／大容量化／省エネ化

⇒豊富な装置ラインナップで対応、スパッタリングターゲット材料やプロセスも合わせて提供



*WLP : Wafer Level Packaging **PLP : Panel Level Packaging

中期経営計画の見直し (幅広い分野での成長戦略)

真空の総合メーカーとしての特長を活かし、**一般産業分野でも幅広い事業を展開**
⇒ **グローバル化を推進**

<熱交換器>

ラジエータ・EGRクーラー・電子部品
冷却等
→真空ろう付け炉、真空漏れ検査

<電動モーター用希土類磁石>

HV・EV等自動車
風力発電・家電製品
→真空焼結炉・溶解炉

<高性能フィルム>

HV・EV等車載高効率キャパシタ
→巻取り蒸着装置シェア90%以上

<樹脂製燃料タンク>

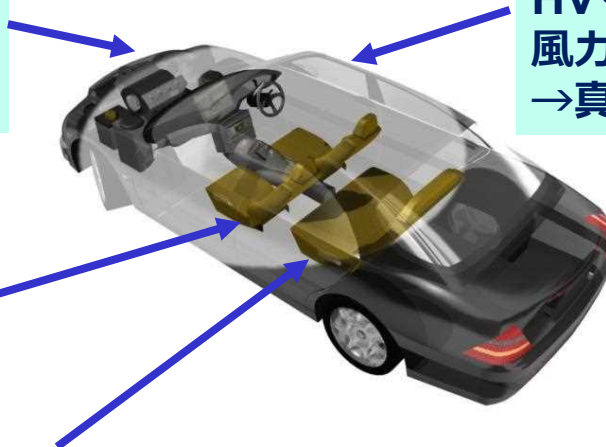
→真空漏れ検査

<製薬・食品>

ジェネリック薬品製造
高純度物質抽出
→真空凍結乾燥装置
真空蒸留装置

<高効率太陽電池>

高効率SHJ※向け
→Cat-CVD装置
世界唯一の商業量産
※シリコン・ヘテロ・ジャンクション



中期経営計画の見直し (コンポーネントの成長戦略)

コンポーネント※の強み

- ・さまざまな機器を内製化
- ・幅広いラインナップ
- ・真空装置との連携による高信頼性
- ・幅広い顧客層
- ・20年以上前から真空ポンプを中国生産



コンポーネントの成長戦略

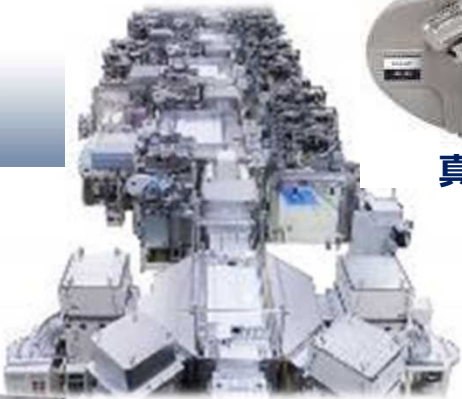
- ・真空用途の拡大（一般産業等）
- ・冷凍機ビジネスの拡大（先端技術等）
- ・中国での装置市場拡大による需要取込
- ・グループのシナジーで生産・販売の拡大
- ・アライアンスによるラインナップの充実



クライオポンプ



真空バルブ



OLED製造用
真空蒸着装置



ドライポンプ



成膜コントローラ



超電導マグネット冷却用4K冷凍機



医療機器MRIの例



大気から液体窒素を
製造、貯蔵する
液体窒素ジェネレーター
研究や医療の現場で、
活躍

※コンポーネント

真空装置には欠かせない機器類

真空ポンプ、真空計、真空バルブ、真空漏れ検査機器、ガス分析機器、成膜用電源等
真空装置メーカーや機械メーカー、装置顧客などへ納入

中期経営計画の見直し (マテリアルの成長戦略)

マテリアル※の強み

- ・顧客近傍に生産拠点（日中韓台）
- ・成膜プロセスと一体となった材料開発
→超材料研究所
- ・量産用実機でのサンプリング体制
- ・新規素材・用途の開発

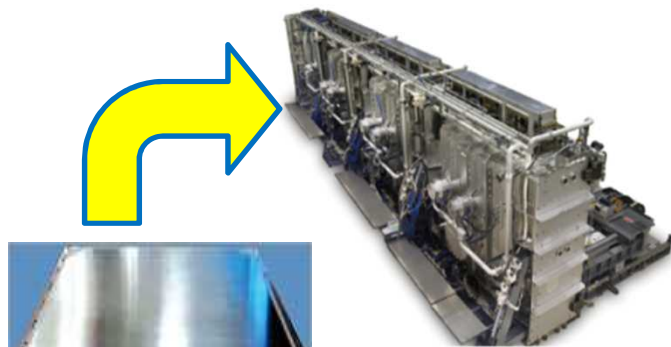
※マテリアル（材料）ビジネス

真空成膜の主流であるスパッタリング法で使用するターゲット材料を中心に事業を展開
機能性材料の開発・製造も手掛ける



マテリアルの成長戦略

- ・中国での装置稼働拡大による需要取込
→中国蘇州工場（FPD・半導体等）
- ・FPD・半導体製造プロセスの高度化に対応
→高精細化（配線材AL→Cu、厚膜化）
→高移動度化（a-Si→酸化物IGZO等）
→フォルダブル化
- ・先端用途への対応
→（高性能加速器向けNb材料等）



スパッタリング
ターゲット

大型TV製造用
スパッタリング装置



スパッタリング
ターゲット

半導体製造用
スパッタリング装置



高性能加速器向け
加速空洞
(高純度Nb材料使用)

中期経営計画の見直し

(カスタマーサポートビジネスの成長戦略)

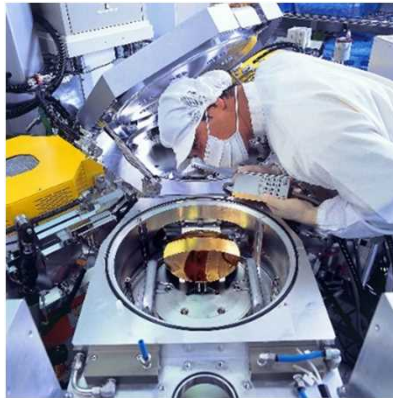
カスタマーサポートビジネスの強み

- ・ライフサイクルのあらゆる場面でサポート
- ・国内・外ネットワーク（顧客至近）
14ヶ国71拠点（日本33、中国15）
- ・コンポーネントも含めた一括メンテナンス
- ・プロセス含めた改善、改良提案



カスタマーサポートビジネスの成長戦略

- ・グローバル展開
- ・フィールドサポート体制の拡充
- ・他社製品のメンテナンス
- ・中古機販売ビジネスの拡大
- ・改造・改善提案の拡大



フィールド
サポート
(保守)

改造・改善

部品販売



リニューアル
中古機販売

洗浄・
表面処理



中期経営計画の見直し (中国市場における成長戦略)

- ・FPD（大型TV・OLED）、半導体電子は国産化政策により投資が活発化
- ・コンポーネント・マテリアル・カスタマーサポートも需要増加

中国における強み

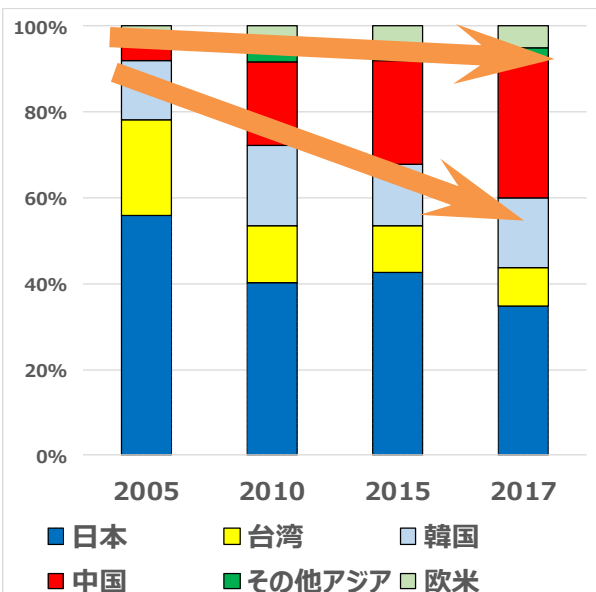
- ・ネットワーク
→15社・約1,600名の従業員
- ・サプライチェーン
→G8.5スパッタリング装置も現地生産
- ・現地経営化



成長戦略

- ・販売・生産体制の強化
- ・FPD・半導体・電子の成長
- ・納入装置増加に伴うコンポーネント、マテリアル、カスタマーサポートビジネスの拡大

中国向け売上高比率の推移



15

中国グループ会社

1,588

従業員数

13

中国製造拠点

15

中国サービス拠点

- 主要製造拠点
- サービス拠点



中期経営計画の見直し (生産体制の強化)

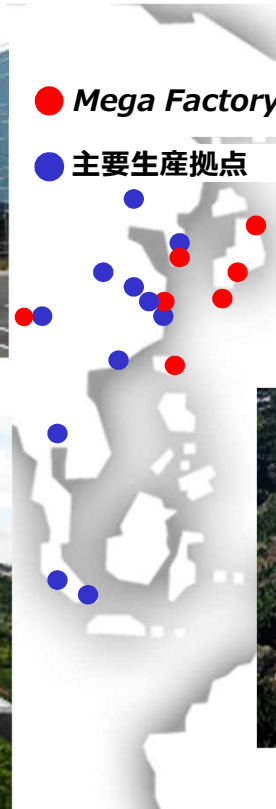
生産・調達面の強み

- ・日中韓台に生産拠点・サプライチェーンを構築済
- ①生産は各拠点間で柔軟に調整
- ②各拠点のエンジニアはボーダレスに対応
⇒売上増加・納期要請等に対応



成長戦略

- ・顧客の近くでの生産
- ・拠点連携によるモノづくり
- ・現地サプライヤーのさらなる拡大



2018年度業績予想

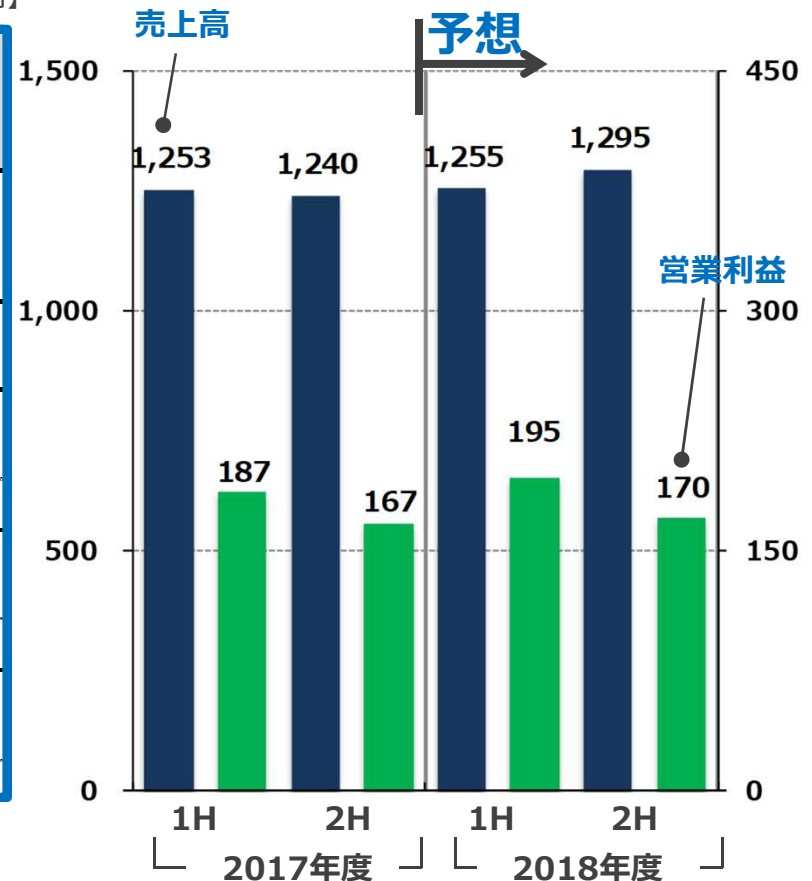
2018年度連結業績予想

- 受注高、売上高、営業利益ともに前年度比増加を見込む
- 当期純利益は、前年度に繰延税金資産等を計上した反動で減少見込み

【単位：億円】

| | 2017年度 実績 | 2018年度予想 | | |
|---------------------|--------------|------------|-------|-----------------|
| | | 2Q (累計) | 通期 | 前年度比 |
| 受注高 | 2,430 | 1,200 | 2,600 | 170 +7.0% |
| 期末受注残高 | 1,000 | 945 | 1,050 | |
| 売上高 | 2,493 | 1,255 | 2,550 | 57 +2.3% |
| 営業利益 | 354 | 195 | 365 | 11 +3.3% |
| 率 | 14.2% | 15.5% | 14.3% | |
| 経常利益 | 369 | 200 | 375 | 6 +1.6% |
| 率 | 14.8% | 15.9% | 14.7% | |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 359 | 140 | 255 | ▲ 104 -29.0% |
| 率 | 14.4% | 11.2% | 10.0% | |

売上高と営業利益の推移（半期毎）

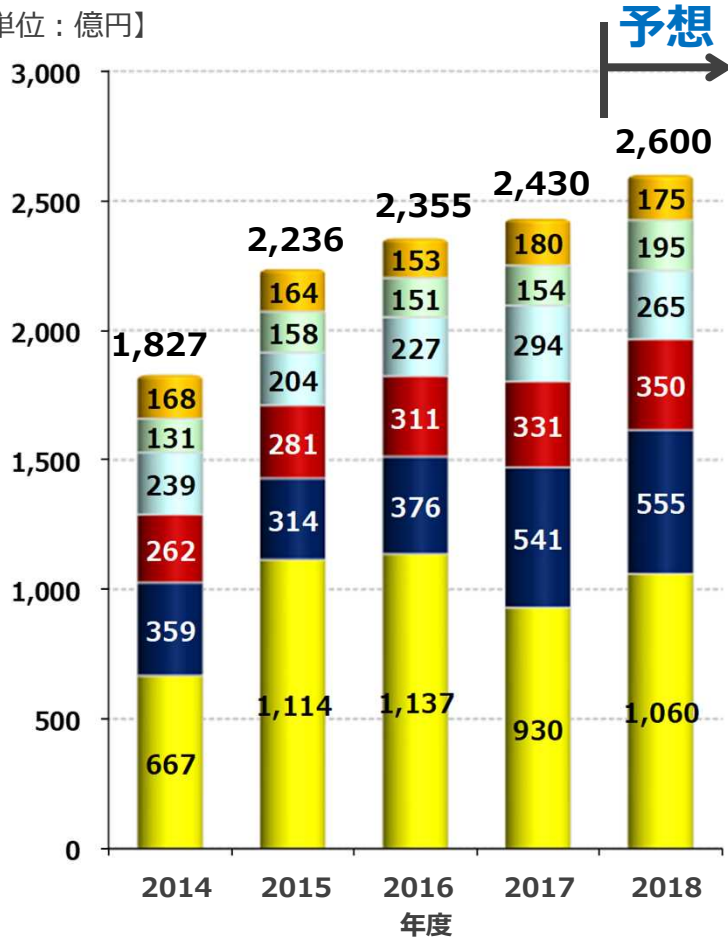


2018年度連結業績予想 (品目別受注高・売上高)

- FPD・PV製造装置は、受注・売上ともに1,000億円レベルが継続
- 半導体・電子部品製造装置やコンポーネントなど他の殆どの品目は前年度を上回る見込み

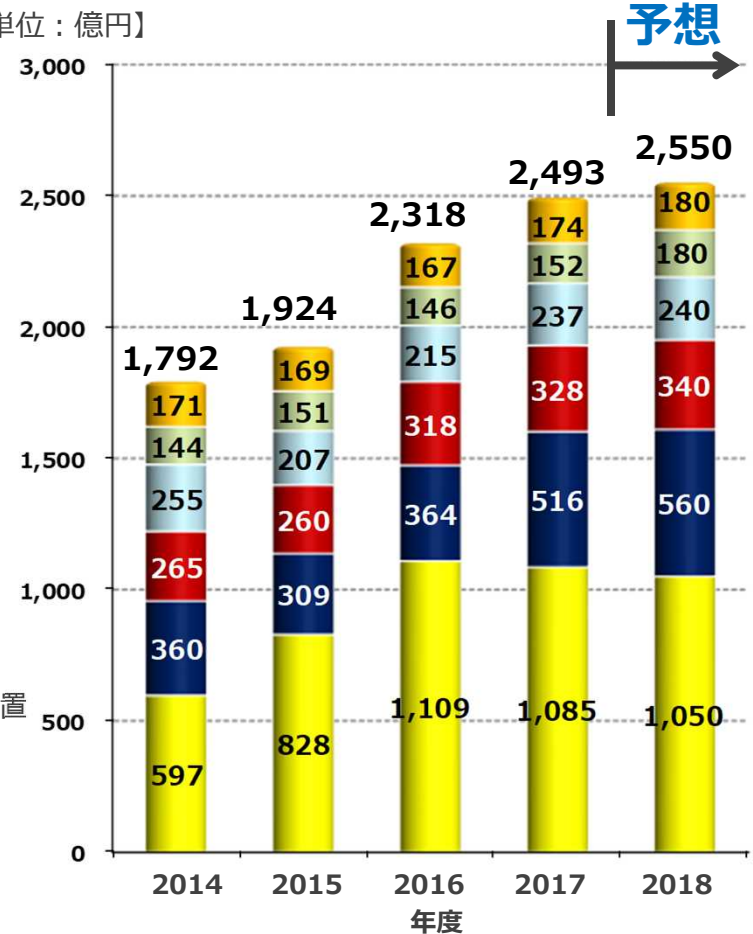
受注高

【単位：億円】



売上高

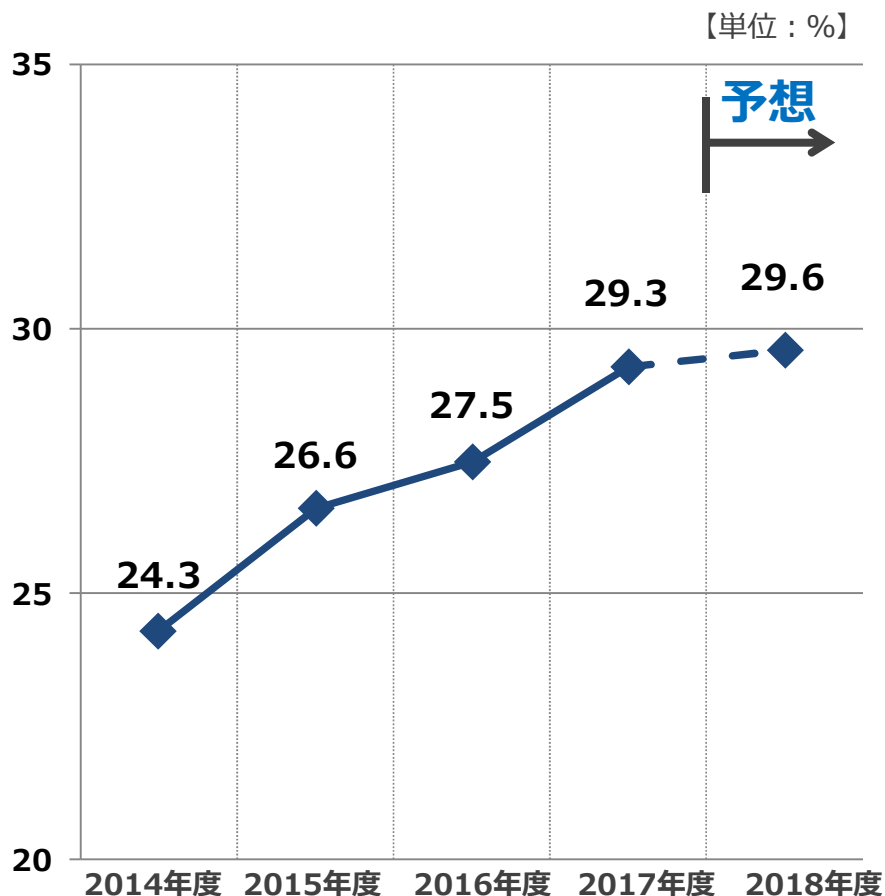
【単位：億円】



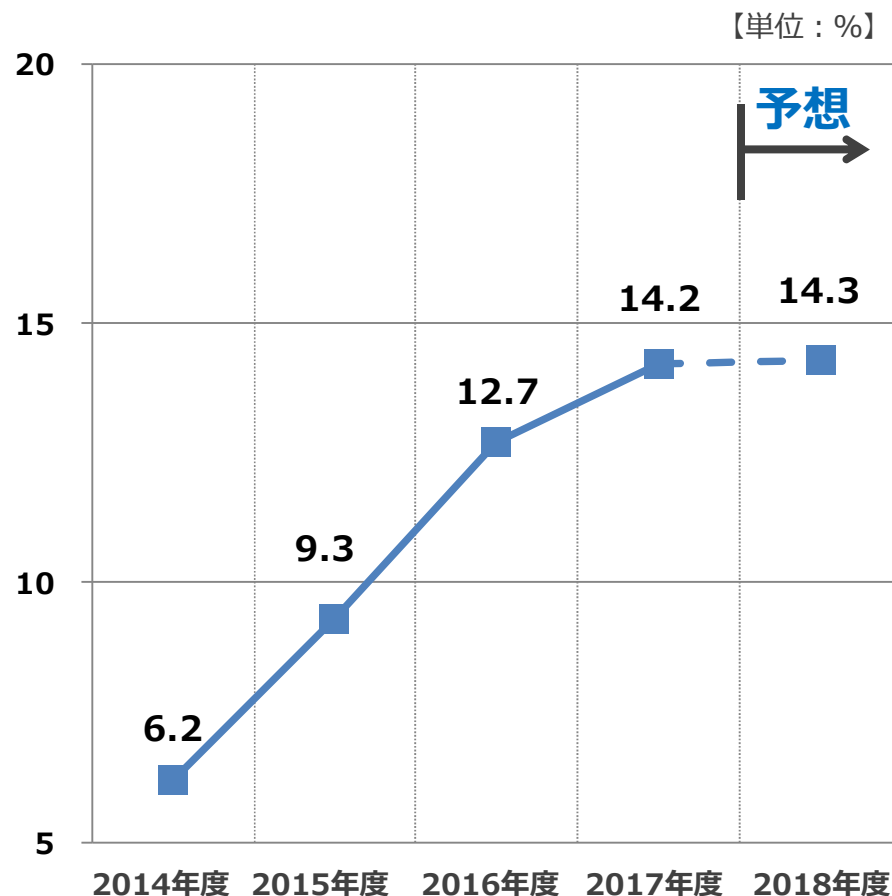
2018年度連結業績予想 (利益率)

- 売上総利益率、営業利益率とも、引き続き高水準で推移する見込み

売上総利益率の推移



営業利益率の推移

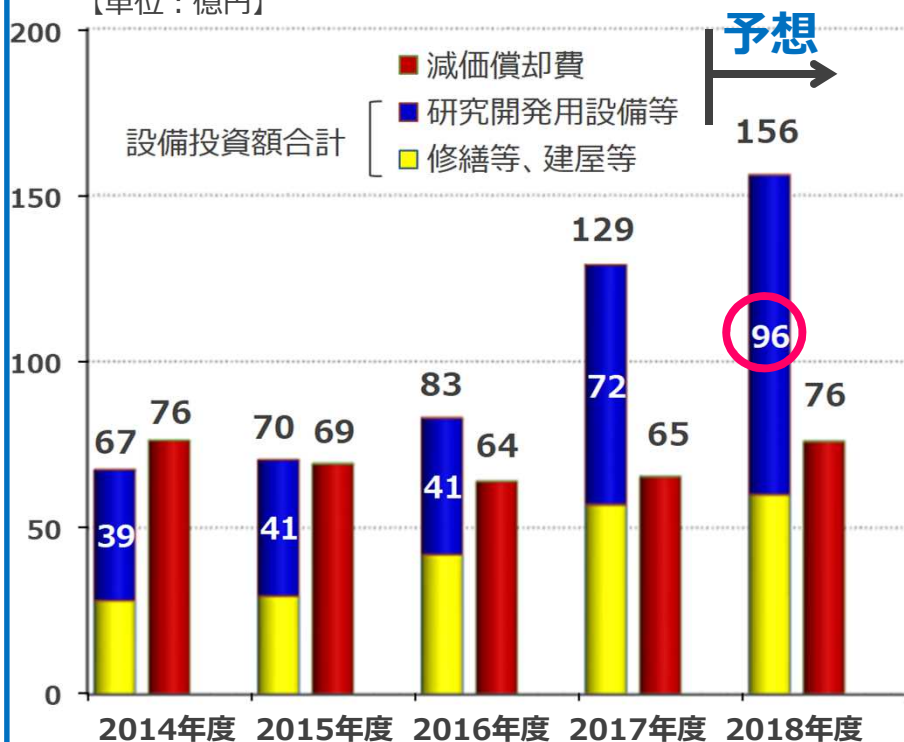


2018年度連結業績予想 (設備投資・研究開発費の推移)

- 研究開発投資（研究開発用設備投資＋研究開発費）は、継続的に増加
- 次世代ディスプレイやロジック・次世代不揮発性メモリなどへの取組みに加え、将来的な成長につながる開発も積極化

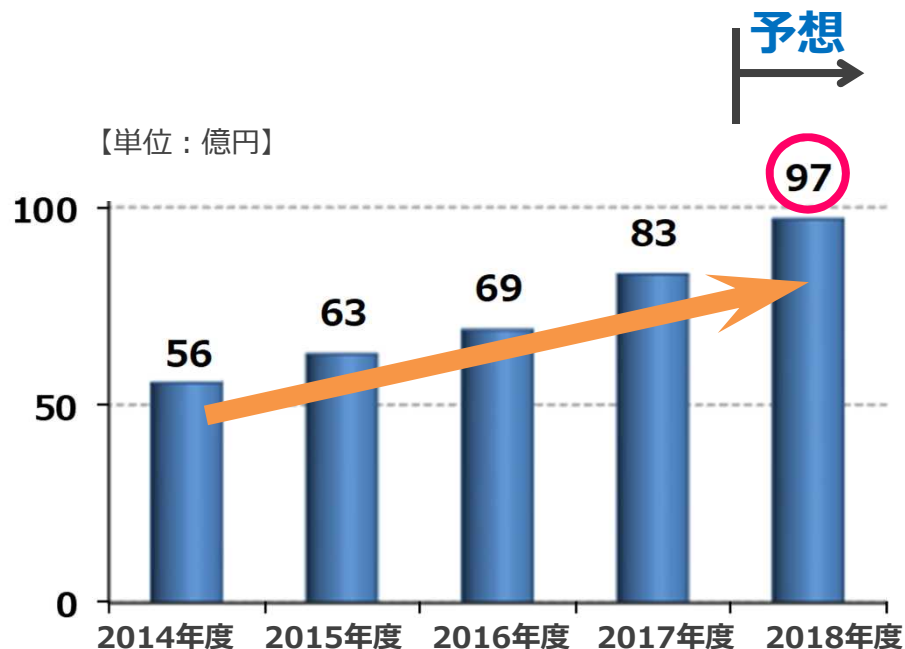
設備投資の推移・予想

【単位：億円】



研究開発費の推移・予想

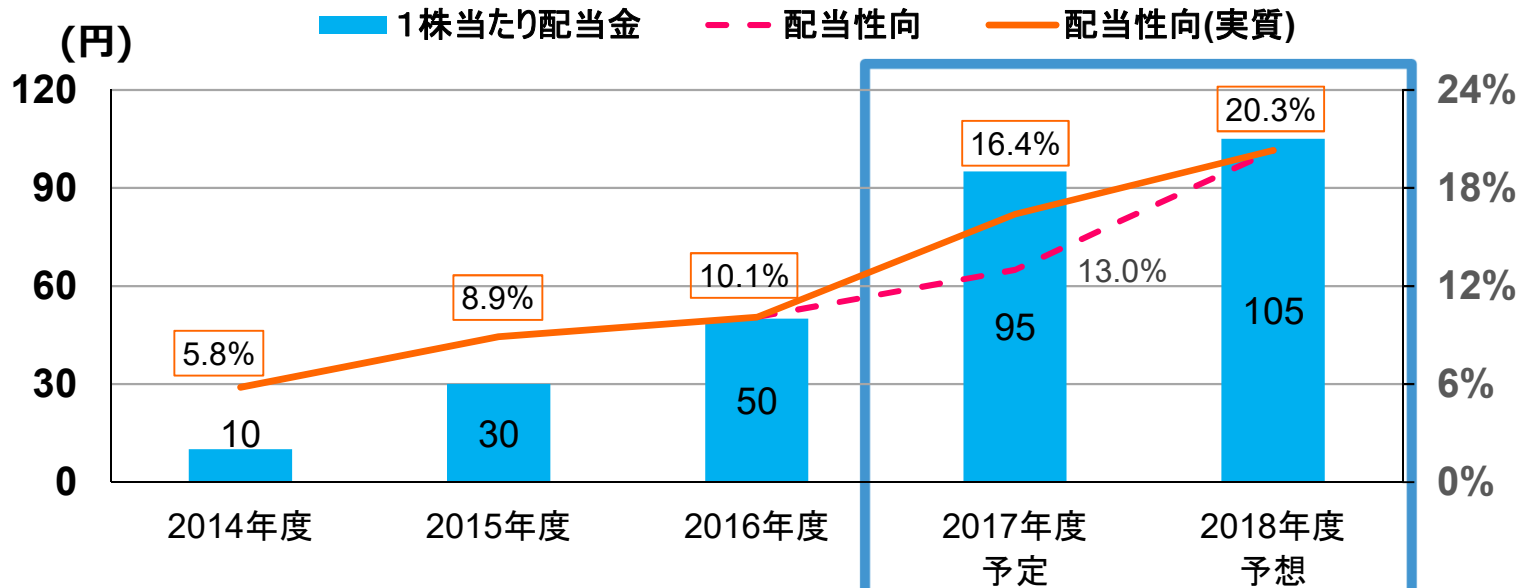
【単位：億円】



2018年度連結業績予想 (期末配当)

配当金は、更なる成長投資のための財務基盤の拡充や各年度の連結業績及び配当性向等を総合的に勘案し、実施する方針

- ・2017年度配当は現行予想どおり 1株当たり95円
- ・2018年度は10円増配の105円の予想
- ・2014年度の復配以降、継続して配当額の引上げを実施



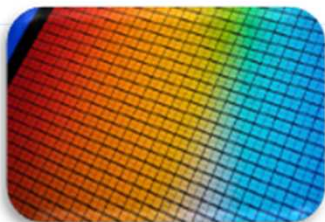
| | 2016年度 | 2017年度 予定 | 2018年度 予想 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 1株当たり配当金 (前年比) | 50円 (+20円) | 95円 (+45円) | 105円 (+10円) |

※ 配当性向(実質)は、繰延税金資産追加計上額及び株式売却益を除いた利益で算出

様々な業界・用途で貢献するアルバックの真空技術



自動車



半導体



フラットパネルテレビ



太陽電池



食品



航空



バイオ



スマートフォン



磁気デバイス



家電製品



宇宙産業



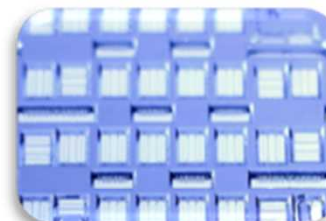
医療・薬剤



ウェアラブル/VR



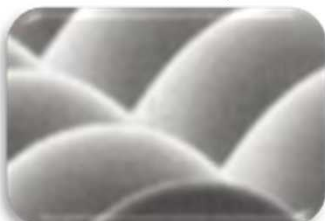
パワーデバイス



MEMS デバイス



建材・スマートガラス



光学



フレキシブル



パッケージング



次世代照明

使用されている写真は、参考イメージです

真空テクノロジーで
「つくる」をつくる、アルバック
ULVAC